

「2015 エポキシ樹脂・応用製品市場の実態と展望」

目次

I 原料編

1 エポキシ樹脂の市場規模

- 1.1 市場展開
- 1.2 市場動向
- 1.3 需要予測

2 エポキシ樹脂の分類

- 2.1 エポキシ樹脂の品種別化学構造
- 2.2 エポキシ樹脂硬化剤
 - 2.2.1 硬化剤の種類と用途
 - 2.2.2 硬化剤の需要量
 - 2.2.3 エポキシ樹脂硬化剤メーカーと銘柄

3 主要エポキシ樹脂メーカーの展開

- 3.1 三菱化学
- 3.2 DIC
- 3.3 新日化エポキシ製造
- 3.4 旭化成イーマテリアルズ
- 3.5 ADEKA
- 3.6 日本エポキシ樹脂製造
- 3.7 日本化薬
- 3.8 長春人造樹脂
- 3.9 南亜塑料工業
- 3.10 江蘇三木集団
- 3.11 藍星集団(中国)
- 3.12 大連齊化化工

4 エポキシ樹脂業界の再編

5 生産能力

- 5.1 国内のエポキシ樹脂メーカーの生産能力
- 5.2 世界のエポキシ樹脂メーカーの生産能力

6 エポキシ樹脂メーカーと製品

- 6.1 日本化薬
- 6.2 新日化エポキシ製造
- 6.3 三菱化学
- 6.4 ADEKA

7 エポキシ樹脂用原料

- 7.1 ビスフェノールA
- 7.2 エピクロルヒドリン
- 7.3 ビスフェノールF

8 主要フォーミュレーターの概要

- 8.1 荒川化学工業
- 8.2 稲畑産業
- 8.3 京セラケミカル
- 8.4 共栄社化学
- 8.5 コニシ
- 8.6 サンユレック
- 8.7 新日鉄住金化学(新日化エポキシ製造)

8.8 信越化学工業

8.9 阪本薬品工業

8.10 スリーボンド

8.11 住友ベークライト

8.12 セメダイン

8.13 ダイセル

8.14 ダイセル・オルネクス(旧 ダイセル・サイテック)

8.15 寺田

8.16 DIC

8.17 ソマール

8.18 ナガセケムテックス

8.19 ナミックス

8.20 日東電工

8.21 日本合成化工

8.22 パナソニック(旧 パナソニック 電工)

8.23 日立化成

8.24 ファインポリマーズ

8.25 ペルノックス

8.26 明電ケミカル

8.27 森六ケミカルズ

8.28 利昌工業

8.29 菱電化成

II 製品市場編

1 電気・電子部品用途

1.1 電気・電子部品用封止材料

1.1.1 樹脂封止材料

1.1.2 セラミック封止材料

1.1.3 封止材料参入企業と製品

1.1.4 電気部品用パッケージの名称と機能

(1) 挿入型

(2) 表面実装型

(3) その他の実装方式

1.1.5 半導体・電子部品封止材料

1.2 半導体封止用エポキシ材料

1.2.1 モールドイングコンパウンドと成形方法

1.2.2 モールドイングコンパウンドメーカーの生産能力

1.2.3 モールドイングコンパウンドの市場規模

1.2.4 半導体市場

1.2.5 半導体封止材メーカーの概要と製品

(1) 日立化成

(2) 住友ベークライト

(3) 京セラケミカル

(4) パナソニック

(5) 信越化学工業

1.3 半導体封止用の充填材料

1.3.1 半導体用エポキシ封止材料の配合例

1.3.2 封止材用充填材料

- (1) 充填剤の種類と要求特性
- (2) 充填剤の表面処理と表面処理剤
- (3) 珪石の原料事情
- (4) 輸入白珪石
- (5) 珪石粉(生粉)
- (6) 封止材料向け珪石製品
- 1.3.3 シリカ材料の表面処理 (シランカップリング剤)
 - (1) 半導体封止材
 - (2) ガラス繊維
 - (3) シーリング材
 - (4) タイヤ材
 - (5) 架橋ポリエチレン
- 1.4 液状エポキシ樹脂封止材
 - 1.4.1 液状エポキシ封止材の概要
 - 1.4.2 市場規模
 - 1.4.3 液状エポキシ封止材メーカーと製品
- 1.5 電子回路基板
 - 1.5.1 電子回路基板の分類
 - 1.5.2 電子回路基板の種類
 - 1.5.3 組成による分類
 - 1.5.4 電子回路用途別材料
 - 1.5.5 電子回路基板の生産推移
 - 1.5.6 電子回路基板メーカー 65社の概要
 - (1) 有沢製作所
 - (2) 愛工機器製作所
 - (3) アスコテック
 - (4) アイン
 - (5) イースタン
 - (6) 板橋精機
 - (7) 伊原電子工業
 - (8) イビデン
 - (9) エイト工業
 - (10) エヌビーシー
 - (11) エルナー
 - (12) オーケープリント
 - (13) 沖プリントドサーキット
 - (14) キヤノン・コンポーネンツ
 - (15) 京セラ SLC テクノロジー
 - (16) 協栄産業
 - (17) 共栄電資
 - (18) キョウデン
 - (19) 邦田工業
 - (20) クローバー電子工業
 - (21) ケイツー
 - (22) コーア
 - (23) サトーセン
 - (24) サンケイプリンティング
 - (25) サンヨー工業
 - (26) 三和電子サーキット
 - (27) シライ電子工業
 - (28) 新旭電子工業
 - (29) 伸光製作所
 - (30) 新神戸電機
 - (31) 新日鉄住金化学
 - (32) 住友電工プリントサーキット
 - (33) 住友ペークライト
 - (34) 総合銘板工業
 - (35) 大昌電子
 - (36) 対松堂
 - (37) 大洋工業
 - (38) ダイワ工業
 - (39) 棚澤八光社
 - (40) ダブル・エー・ピー
 - (41) TSS
 - (42) デンソー
 - (43) 東海神栄電子工業
 - (44) 東芝ホクト電子
 - (45) 東和プリント工業
 - (46) 栃木電子工業
 - (47) 日東電工
 - (48) 日本サーキット工業
 - (49) 日本シイエムケイ
 - (50) 日本発条
 - (51) 日本ミクロン
 - (52) 日本メクトロン
 - (53) 八光電子工業
 - (54) パナソニック
 - (55) 日立化成
 - (56) 平山ファインテクノ
 - (57) 富士通インターコネクトテクノロジーズ
 - (58) 富士プリント工業
 - (59) マルフジ製作所
 - (60) メイコー
 - (61) メッツエレクトロン
 - (62) 山下マテリアル
 - (63) 山一電機
 - (64) RITA エレクトロニクス
 - (65) リョウワ
 - (66) ワイケージー
- 1.6 LED
 - 1.6.1 LED の市場動向
 - 1.6.2 LED 封止材の市場規模
 - 1.6.3 LED 封止材参入メーカー
 - 1.6.4 LED パッケージ
 - 1.6.5 LED の市場規模
 - (1) LED の用途
 - (2) 市場規模
 - 1.6.6 主な LED パッケージメーカーと製品
- 1.7 アンダーフィル材
 - 1.7.1 アンダーフィル材の概要
 - 1.7.2 アンダーフィル材の市場規模
 - 1.7.3 アンダーフィル材メーカーと製品
- 1.8 ダイボンドペースト・フィルム
 - 1.8.1 ダイボンドペースト・フィルムの概要
 - 1.8.2 ダイボンドペースト・フィルムの市場規模
 - 1.8.3 ダイボンディング材料メーカーと製品
- 1.9 導電性材料
 - 1.9.1 導電性材料の種類と要求特性
 - 1.9.2 導電性材料の市場規模
 - (1) 導電性接着剤 (ペースト)
 - (2) 導電性塗料
 - 1.9.3 導電性ペーストの接着剤・塗料メーカーと製品

- 1.10 UV 硬化性樹脂
 - 1.10.1 UV 硬化性樹脂の市場動向
 - 1.10.2 エポキシアクリレートオリゴマー
 - 1.10.3 UV 硬化型樹脂の特長
 - 1.10.4 UV 硬化樹脂の市場規模
 - 1.10.5 UV・EB 硬化用オリゴマー参入企業
 - 1.10.6 UV 硬化材料メーカーと製品
 - 1.10.7 UV インキメーカー
- 1.11 その他電子部品の動向
 - 1.11.1 抵抗器
 - 1.11.2 コンデンサ
 - (1) 用途による分類
 - (2) コンデンサの種類とメーカー
 - 1.11.3 変圧器、コイル
 - 1.11.4 電子デバイス
 - 1.11.5 ハイブリッド IC
 - 1.11.6 水晶デバイス
 - 1.11.7 電気・電子部品向けのエポキシ配合樹脂の用途別需要量
 - 1.11.8 電子部品用エポキシ樹脂メーカーと製品

2 その他製品

- 2.1 繊維強化材料
 - 2.1.1 カーボンファイバー
 - (1) カーボンファイバーの種類と用途
 - (2) 原糸形態別の分類
 - (3) カーボンファイバーのメーカー生産能力
 - (4) カーボンファイバーの国内出荷量推移
 - (5) カーボンファイバーの事業形態とプリプレグ
 - (6) プリプレグ用樹脂
 - 2.1.2 グラスファイバー
 - (1) FRP
 - (2) FRP 用途と樹脂使用状況
- 2.2 エポキシ樹脂系接着剤
 - 2.2.1 需要動向
 - 2.2.2 エポキシ樹脂系接着剤の市場規模
 - 2.2.3 エポキシ樹脂系接着剤メーカーと製品
- 2.3 エポキシ樹脂塗料
 - 2.3.1 種類と特徴
 - 2.3.2 エポキシ樹脂塗料の生産動向
 - 2.3.3 粉体塗料
 - 2.3.4 粉体塗料の生産動向

III 中国のエポキシ樹脂市場編

- 1 中国のエポキシ樹脂生産能力
 - 1.1 中国のエポキシ樹脂メーカーと生産能力
 - 1.2 日系フォーミュレーター
 - 1.3 その他のメーカー
- 2 エポキシ樹脂需給バランスシート
- 3 エポキシ樹脂需要動向
 - 3.1 エポキシ樹脂需要量（中国）

- 3.2 エポキシ樹脂輸出入動向
- 3.3 中国及び香港の輸入、輸出統計
 - (1) 中国本土
 - (2) 香港

4 主要需要先

IV 世界のエポキシ樹脂市場編

- 1 エポキシ樹脂の世界需要
 - 1.1 世界における需要金額
 - 1.2 世界における需要用途